

アナリスト向けIRミーティング

2025年1月9日

シライ電子工業株式会社

プリント配線板を一気通貫でグローバルに供給するだけでなく、
検査装置・マテハン装置等のソリューションビジネスも展開しております

国内外の自社工場だけでなく、OEM調達により
幅広い分野の製品提供が可能
グローバル品質保証によりシライ品質を担保し、
小ロットや短納期にも対応可能

ソリューション事業

製造現場で蓄積されたノウハウを詰め込んだ
自社開発の検査機で不良品の流出を防止
お客様に安心と安全をお届け

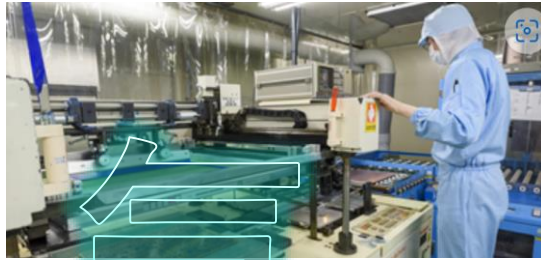
プリント配線板事業

設計・試作



幅広い要望に応じた設計が可能
試作リードタイムは最短中1日で提供可能

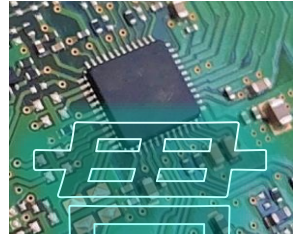
製造



検査



実装



顧客の要望に応じて、協力会社と
連携し実装業務を提供。営業戦略
の方針次第で今後拡大の余地あり

一気通貫

(単位：百万円)	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	24年3月期
売上高	28,632	26,135	22,355	29,397	32,864	28,833
営業利益	362	-98	119	1,558	2,833	2,307
親会社株主に帰属する当期純利益	-226	-500	-208	1,327	2,063	1,487
有利子負債(リース債務除く)	10,764	11,126	11,593	10,382	7,548	5,296
1株当たり配当(円)	5.0	0	0	10.0	22.0	26.0

コロナ

3期連続最終赤字

分析サマリー

構造改革始動

業績V字回復

最高益更新

当社は、2015年度以降業績が伸び悩む中、2018年度には最終赤字に転落、2020年にはコロナ禍に見舞われ、経営の危機的状況に陥った。そうした中、2020年に現社長の五藤を中心に抜本的な経営構造改革骨子を作成・提言した。
選択と集中による業績改善施策、及び全社的な意思決定の迅速化と成功体験の共有の積み重ねを行い、その結果、**2021年度からV字回復**を果たし、損益構造及び組織風土を変革させることに成功した。

中期経営ビジョン

**『盤石な経営基盤を築き、中長期的に
安定した経営と未来の成長を実直に実現！』**

経営方針

**『原点に回帰し、一枚岩となる事で意思決定の迅速化を図り、
お客様等のステークホルダーに価値を提供する』**

『安定した経営』に向けて

- ①意思決定の迅速化で、不確実な経営環境に柔軟に対応する
- ②シライ電子の人的資本を強化すべく、従業員の処遇改善とエンゲージメントの向上を目指す
- ③競争力強化の為の適正な投資(省力化&更新投資、IoT化等)を行い、労働生産性を向上させる

中期経営目標（売上、利益）

（単位：百万円）	24年3月期(実績)	25年3月期	26年3月期	27年3月期
売上高	28,833	29,000	30,500	33,000
営業利益	2,307	2,400	2,500	2,600
経常利益	2,161	2,200	2,300	2,400
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,487	1,500	1,600	1,700

- 成長分野と成長市場を見据えた技術開発と新規開拓を推し進め、既存事業の売上をベースに、新たな売上を積み上げて行く。
- 製造業の国内回帰（需要増）や、プレーヤー（同業）の減少によるビジネスチャンスを逃さず、着実なポジションを獲得する。
- 長期的且つ持続的成長のため、必要な投資とコストは惜しまずも、利益率は同業他社以上の水準を目指す。



（単位：百万円）	24年3月期(実績)	25年3月期	26年3月期	27年3月期
有利子負債	5,296	4,300	3,300	3,000
純資産	7,930	8,900	9,900	11,000
D/Eレシオ（倍）	0.67	0.49	0.33	0.27
ROE	19.0%	18.0%	17.2%	16.4%

- 今後は有利子負債を適正水準まで削減し、金利上昇による支払利息増加のリスクを低減する。
- 2027年3月期には、資本コスト(WACC)の適正化を意識して、D/Eレシオで0.3～0.4を目指す。



創業以来培ってきた「信頼」を大切にしながら、
未来の成長に向けて成長市場・成長分野にシライ品質を提供してまいります



成長市場

経済発展・市場規模の拡大が期待される
ASEAN・インド地域に販路を拡大し、
信頼できるシライ品質製品を提供する

成長分野

顧客ニーズを収集分析しシライが提供する製品、
サービスラインナップを拡充する

- モビリティ業界の電動化
- パワー半導体
- エネルギーソリューション etc.

「未来の成長に向けて」 **成長市場**及び成長分野を見据えた技術開発と新規開拓を推進してまいります

【ASEAN・インド市場のビジネス拡大】

当中期経営計画の対象期間においては引き続き日本・中国がボリュームゾーンであるものの、経済発展著しい**ASEAN**・**インド**を次のシライ電子の柱に育て上げます。

ASEAN

ASEAN市場は経済成長、生活水準の向上による電子機器の需要増で今後の高い成長が見込まれます。特にタイは製造業のカントリーリスクの回避先として有望であり**プリント配線板の世界シェアも現在の4%から26年以降は10%に伸長**するとみられています。

当社はタイの販売子会社を軸に現地アライアンス先との**品質最優先**での協業深化で、お客様の地産地消のご要望に強く応えてまいります。

インド

人口で中国を上回り世界一となったインドでは、豊富な労働力を背景に今後も高い経済成長(CAGR18%)が期待されています。

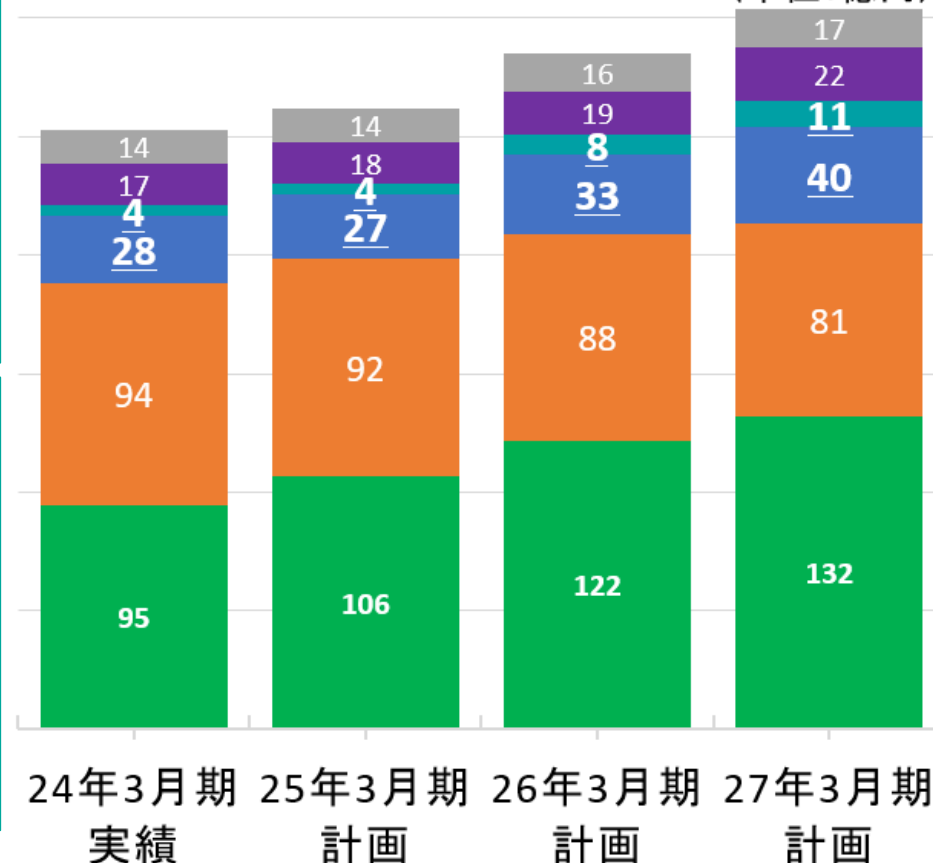
同国においてお客様からの要望が強いインド産品供給のため、**2025年4月までに現地販売子会社を設立予定**です。現地アライアンス先との協業強化し、創業以来大切にしてきたシライ品質を担保したプリント配線板を供給できる体制を構築してまいります。QCDS全てにおいて付加価値を創出し、お客様満足の上を目指します。

中長期的に日本・中国市場とともにシライ電子の柱になることを目指します。

プリント配線板事業 市場別 売上高計画

■ 日本 ■ 中国 ■ ASEAN ■ インド ■ 南北米 ■ 欧州

(単位:億円)



「未来の成長に向けて」成長市場及び**成長分野**を見据えた技術開発と新規開拓を推進してまいります

【モビリティ業界の電動化】

世界の自動車用 PCB 市場規模 2023年度：91億米ドル→2032年度：151億米ドル
電装化・EV化等により予測期間においてCAGR 5.9%と高い成長が見込まれています。
この成長を見越し、**既存リソース（両面、多層） + α** でシライ電子が提供可能な製品を拡大させます。

具体的には、車両の電動化でバッテリー、モーター、インバータ等の主要コンポーネンツに対して必要とされる**サーマルマネジメント**を重要なキーワードと捉え、**厚銅基板、金属ベース基板等の放熱商品**をお客様にご提案してまいります。

特に厚銅基板の売上高は24年度：0.4億円→27年度：4億円と高成長させることを目標に、技術・製造・販売が三位一体となって「**一枚岩**」で事業を進めてまいります。

【パワー半導体】

電力変換、電力制御が必要とされる**EV、再生可能エネルギーシステム等の高電力、高電圧アプリケーション**に使用されるパワー半導体需要が増加。比例して**プレスフィット実装**が増加すると予測されます。同実装に対応できる体制(穴径精度管理、錫めっき)で販路拡大を目指します。

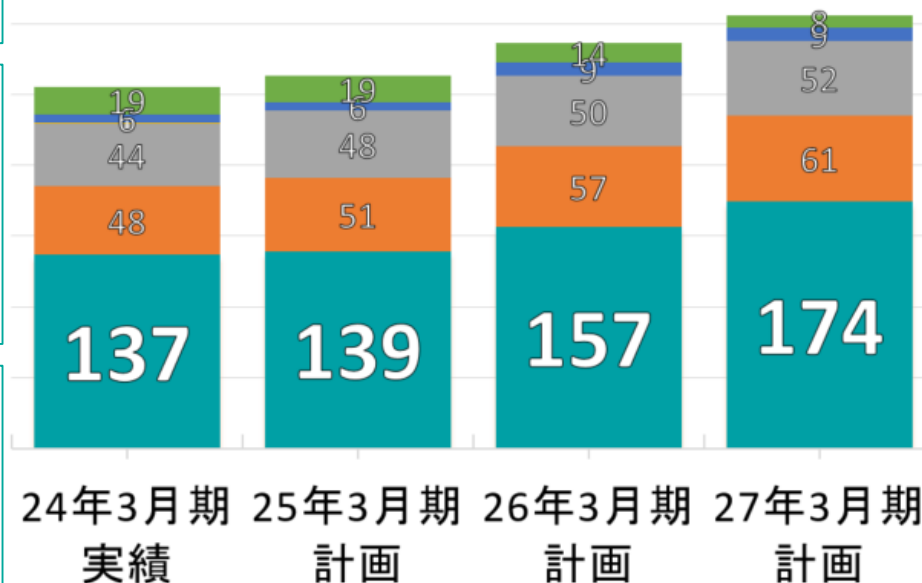
【エネルギーソリューション】

エネルギーの効率的な利用と環境負荷の低減を目指す技術・製品の拡大が見込まれております。エネルギー使用の最適化、無駄を減らす為のスマートメーター、再生可能エネルギーの不安定な供給を補うための蓄電池等の分野に対して、長期信頼性に優れた商品を提案してまいります。

プリント配線板事業 分野別 売上高計画



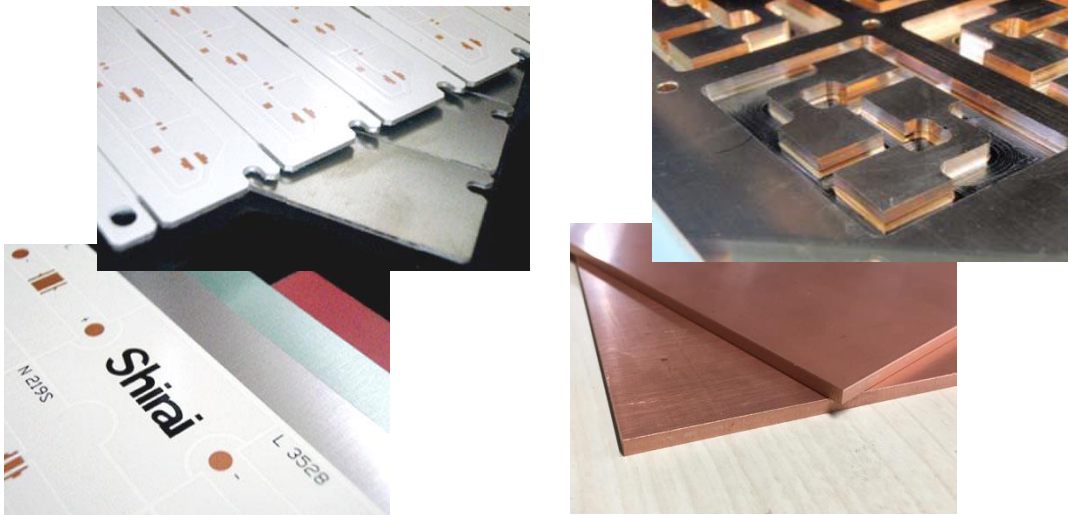
(単位:億円)



「未来の成長」に向けて高品質・高付加価値分野へ注力し、ビジネスチャンスを拡大します

金属ベース基板

- ・放熱特性に優れ発熱量の大きなLED照明、映像ディスプレイ、パワーデバイス等に活用できます
- ・今後市場が拡大するサーマルコントロール商品に適した特性を有しています
- ・シライの製造技術で製品品質を高め、市場ニーズに合わせた製品をお届けします

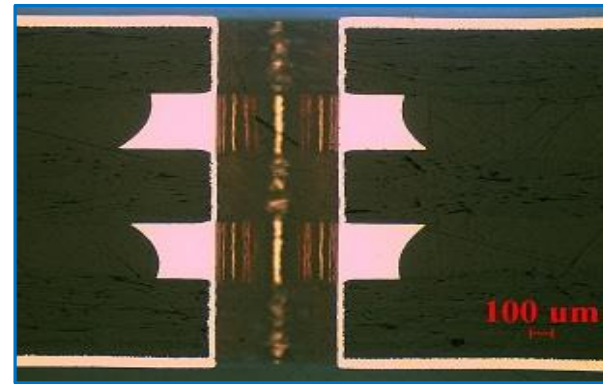


アルミベース基板

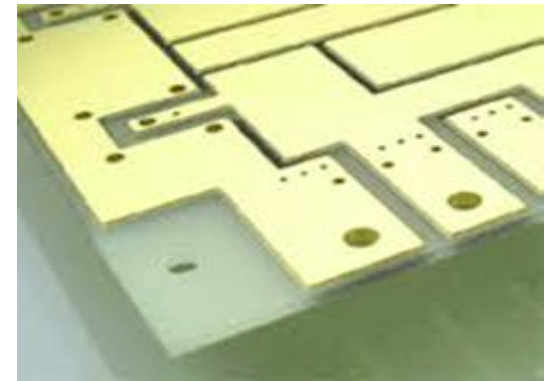
銅ベース基板

厚銅スルーホール基板

- ・高電流、高電圧、高放熱、高耐久等の特性を持つ基板です
- ・車の電動化が進みバッテリーやモーターの電子制御に大電流が必要な商品へ対応しています
- ・環境対応で市場拡大が見込める蓄電池や太陽光発電など様々な分野で高需要が見込まれます



厚銅多層基板

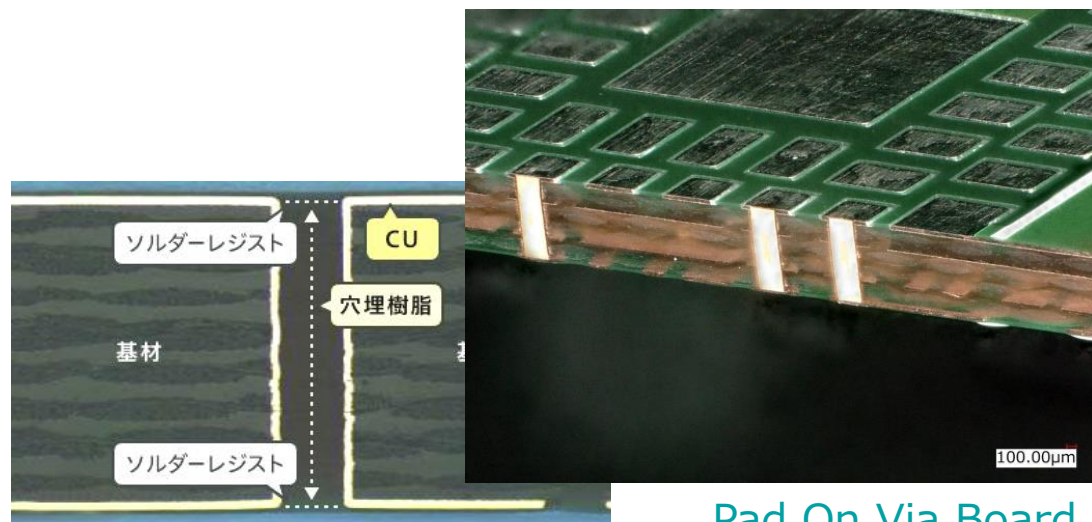


厚銅両面基板

「未来の成長」に向けて高品質・高付加価値分野へ注力し、ビジネスチャンスを拡大します

フラットプラグ基板

- ・スルーホールを樹脂埋めし、保護するとともに表面の特殊研磨による平滑仕上げを施すことで部品の実装面積拡大と高密度化が可能となる基板です
- ・事務機器、通信機器など幅広い電子機器分野に活用されています



Flat Plug Board

Pad On Via Board

プレスフィット接続対応基板

- ・プレスフィット構造により、実装工程での工数低減・はんだレスとなることで、使用エネルギー量削減と製造コストの低減が可能となる基板です
- ・プレスフィット構造でのダイレクト接続が可能となりパワー半導体や車載部品への活用を目指しています
- ・錫めっき対応と加工精度を高めた、信頼性の高い商品が提供可能です



プレスフィットピン挿入基板

「未来の成長」に向けて製造工程の可視化と自動化により工場のスマート化を進めてまいります

生産設備のIoT管理

- ・ 自製プログラムの活用により、今後も更なる生産稼働率の向上を追求してまいります
- ・ 創業来の生産活動で蓄積しているノウハウを活用し先進的なスマート工場化を実現します



生産の自動化推進

- ・ 人に起因する不良発生を減らし、生産性が向上します
- ・ 人件費の高騰、慢性的な人手不足等のリスクが低減し、安定生産が可能となります
- ・ **ソリューション事業部**が得意とする分野であり、創業来、蓄積してきた製造ノウハウを活かした社内コラボが可能です



導入イメージ図

基板製造ノウハウを有するシライ電子が設計・販売するソリューション製品を幅広く展開します

外観検査機：VISPERシリーズ

～A V I (Automatic Visual Inspection)
からS V I (Smart AVI) に～
顧客が満足できる品質の製品を、メーカーが
安心して出荷できる検査機で、人手の
掛からないスマートな自動検査を実現します



目視検査アシストシステム： ハイエンドTREMY

拡大検査の効率化、高倍率対応で、
プリント配線板以外の市場への拡大
を目指します



簡単調整吸着パッド：S-PAD

吸着が難しいプリント配線板等の
吸着搬送を無調整で確実に実現し、
投入機や受取機等のマテハン装置と
組み合わせる事で生産性が向上します



従業員が笑顔で活躍できる企業を目指し、多角的な人財施策を実行します

人財戦略の方向性

従業員のエンゲージメントを最重要視し、結果として「シライ電子ファン」を増やすことを目指します。
エンゲージメントの向上により個人の知識・能力を高める環境を整え、その英知を結集し組織力を高めます。また、挑戦することを促すため、失敗を許容し失敗と向き合うことで失敗→経験に変換し、経験を蓄積する風土を醸成します。
これらにより、当社グループ最大の競争力の源泉であるチームワークを機能させ、結果として経営方針に定めたグループ全体の「一枚岩」がより強固になると考えております。

【エンゲージメントの向上】

- ・従業員の待遇向上
- ・社内イベント等の開催によるコミュニケーションの活性化
- ・成功体験の共有

【個人の知識・能力の強化】

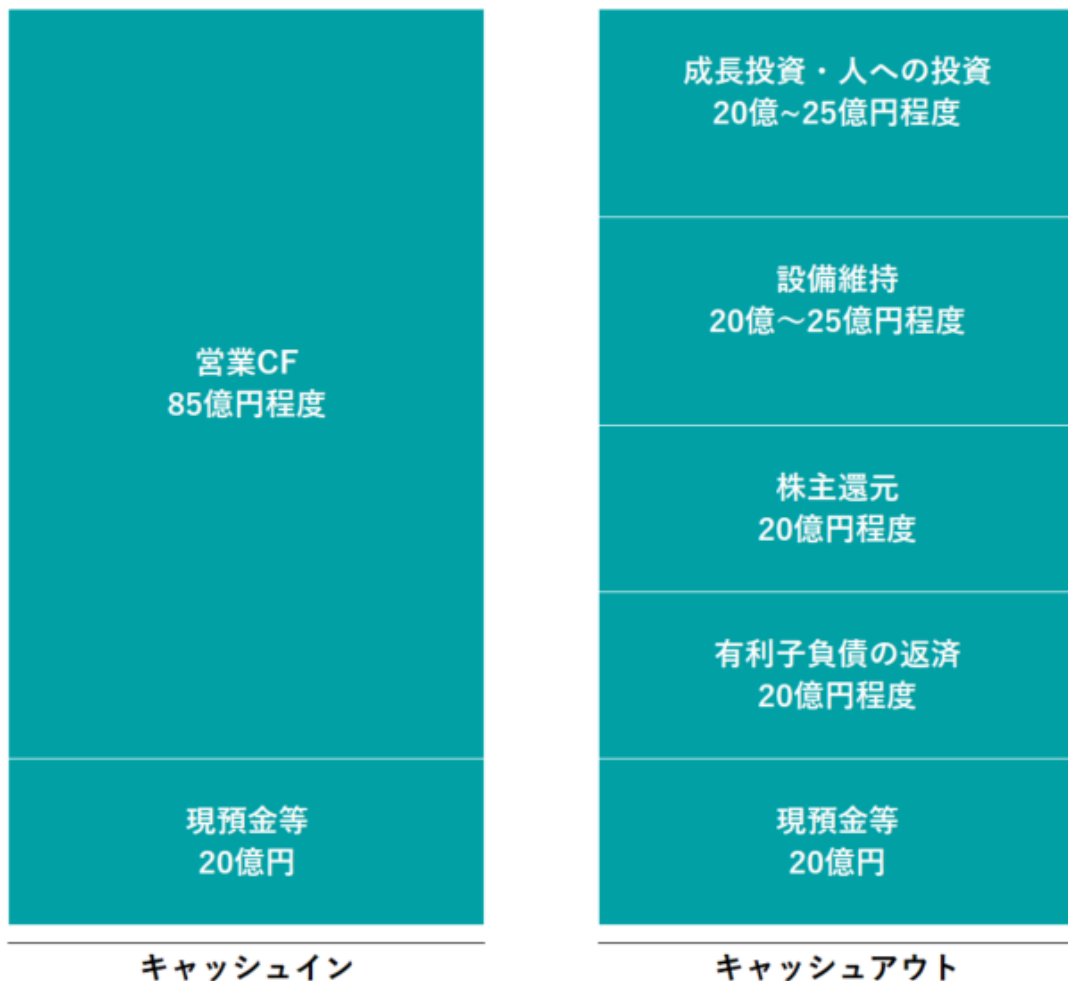
- ・社内外の研修参加を推進
- ・国内外含む人事異動によるキャリアアップ
- ・資格の取得支援

【組織力の向上】

- ・風通し良く建設的な意見を出し合い多角的な議論を通じて組織としての判断を形成
- ・この判断の積み重ねこそが組織力、企業価値の向上の源泉

社会生活に欠かせないプリント配線板の安定供給のため、健全な財務基盤を維持しつつ、
適正な未来への成長投資、持続的な株主還元を実行します

25年3月期から27年3月期のキャッシュイン・キャッシュアウト



「未来の成長」に向けた投資

積極的に成長市場・成長分野への投資を行う
開発投資、M & A、DX推進や、SDGsへの貢献も視野に
人的資本に対する投資も積極的に行う

既存設備維持・更新のための投資

競争力を維持するための老朽化対策や設備更新

株主還元

中長期のTSRを意識した配当政策と資本政策を実行

有利子負債の返済

健全な財務基盤維持のため、適正な水準まで
有利子負債の返済を継続する

「事業の成長」と「株主還元」を長期的な視点で考慮し、安定的かつ継続的に株主還元施策を実行します

方針

株主リターン(TSR)を高めるため、配当と株価上昇の双方を意識し財務資本政策を実行します。
業績の成長に合わせて増配し、成長投資を考慮しながら配当性向を向上させます。
株価水準によっては自己株式の取得を検討し、当中期経営計画期間における総還元性向を40%程度まで高めることも検討します。

(単位：百万円)

	24年3月期 (実績)	25年3月期	26年3月期	27年3月期
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,487	1,500	1,600	1,700
配当性向	24.8%	30%	30%	35%

基板の製造から生じる環境負荷を低減し、業界全体のサステナビリティに貢献します

方針

「地球と地域と共に歩む」のメッセージのもと、循環型社会を構築する一員としてシライ電子グループ全体で環境と経営の両立に向けた取組みを実施してまいります。

最先端の廃水処理システム

高度な膜処理システムを採用し、業界最高水準の排水基準値を実現しております。

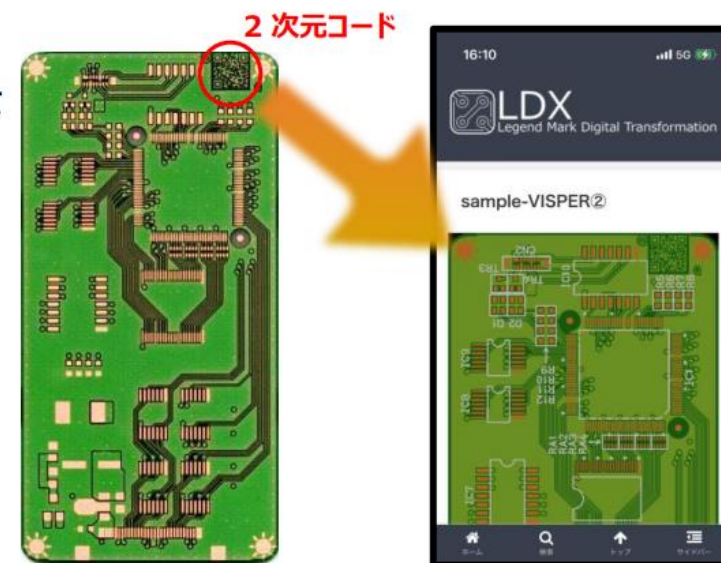
銅濃度0.1ppm以下、COD50ppm以下



当社グループ 珠海工場

環境対応型 LDX（シンボルレス基板）

シンボルマーク情報を閲覧できる URL を組み込んだ 2 次元コードを製品表面にパターン形成したプリント配線板。当該 2 次元コードをスマートフォン等で読み取ることで、デバイス画面上でシンボルマークを視認できる。シンボルマーク印刷工程を無くすことで資源やエネルギー消費の低減、不良廃棄の削減等が可能となります。



※特許取得済

環境活動

地球環境のため省エネ活動や廃棄物の低減活動に積極的に取り組んでおります。
2030年度にGHG排出量を2013年度比で半減し、
2050年度にはネットゼロを目標に掲げております。

温室効果ガス排出量実績（Scope 1・2）

2013年度 (基準年度)		2021年度	2022年度	2023年度		2026年度 (目標)
60,475	・・・	60,265	57,021	50,635	・・・	47,340

工場に設置の太陽光パネル



コージェネレーション設備



ファクトリーパーク(一般開放)

ガバナンス

各ステークホルダーとの適切な信頼関係を構築するため、
今後も継続してコーポレートガバナンスの強化に取り組んで
まいります。
企業活動の透明性を高め、企業価値の向上に努めてまいります。

テーマ	今後の取り組み
優れた経営責任者の 育成と選任	・ 経営の視点を学ぶ教育研修の実施 ・ 最高経営責任者の選任プロセスの明確化、指名報酬委員会の積極的な関与
独立社外取締役の 増員と強化	・ 適切な経験と能力を有する独立社外取締役の人数を少なくとも取締役総数の1/3以上を占めるよう選任 ・ 社外取締役に対する経営情報共有の十分性・適時性の強化
取締役会の実効性評価と 機能の充実	・ 取締役会実効性評価に適したアンケートの実施及びその結果の分析評価を基にガバナンスの更なる改善 ・ 経営に対して適切な評価と有益な助言を期待できるスキルや経験を特定し、最適な取締役を選任
社員全員参加による 経営の透明性向上	・ 役員、管理職、非管理職がフラットにコミュニケーションをとれる環境作り ・ 従業員のエンゲージメントを重視し、人事制度やインセンティブを見直し



お問い合わせ先

シライ電子工業株式会社 経営管理部

TEL : 077-586-1333

URL : <https://www.shiraidenshi.co.jp>

E-mail : ir-inquiry@shiraidenshi.jp

（ご注意）

本資料の業績予想等は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、グローバル化・製品市場の動向、原材料・人件費・その他資材価格の変動、急激な技術革新、為替変動、政治・貿易摩擦、国際紛争、その他様々な不確実性の影響で、実際の値は予想と異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。